

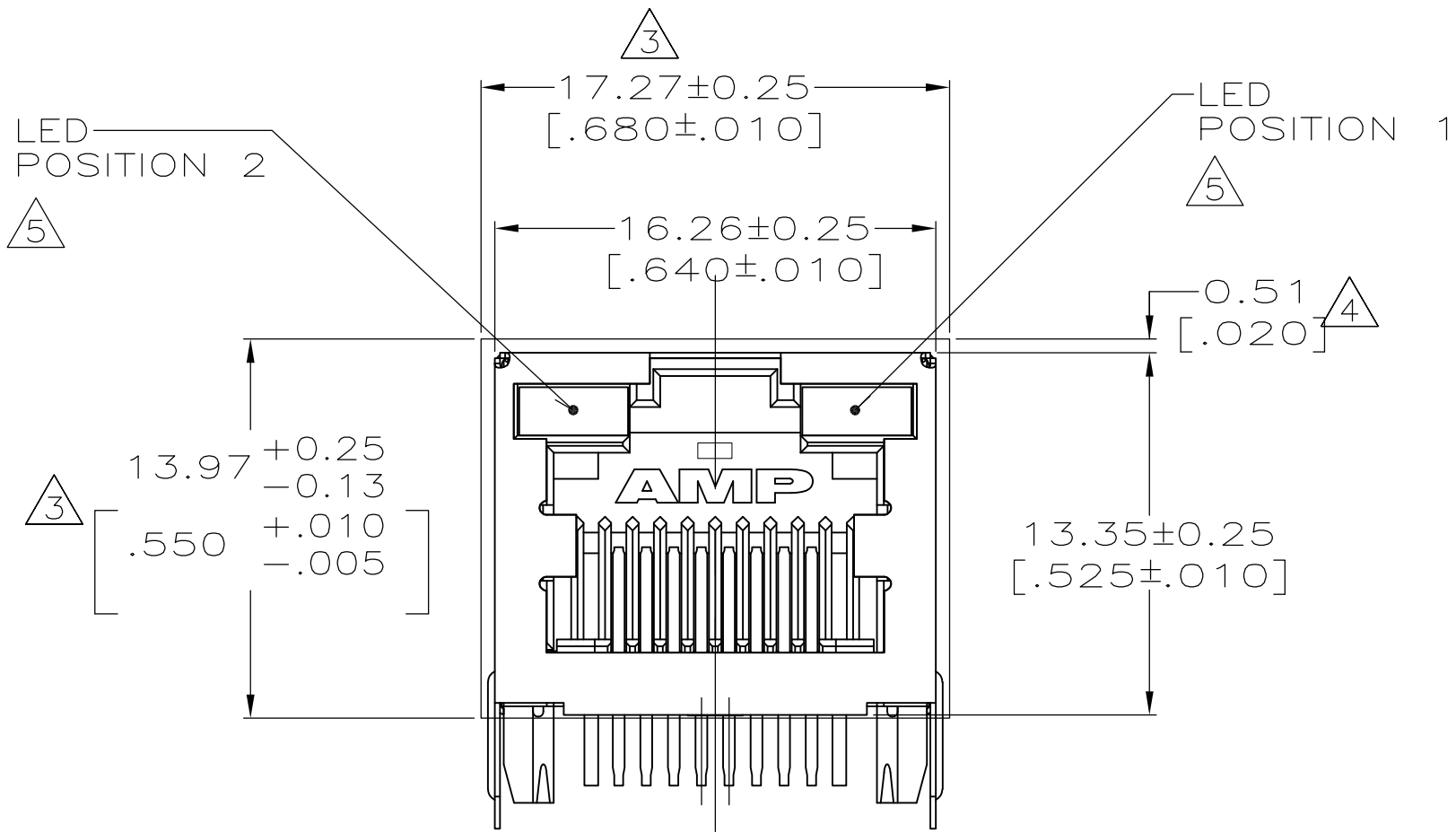
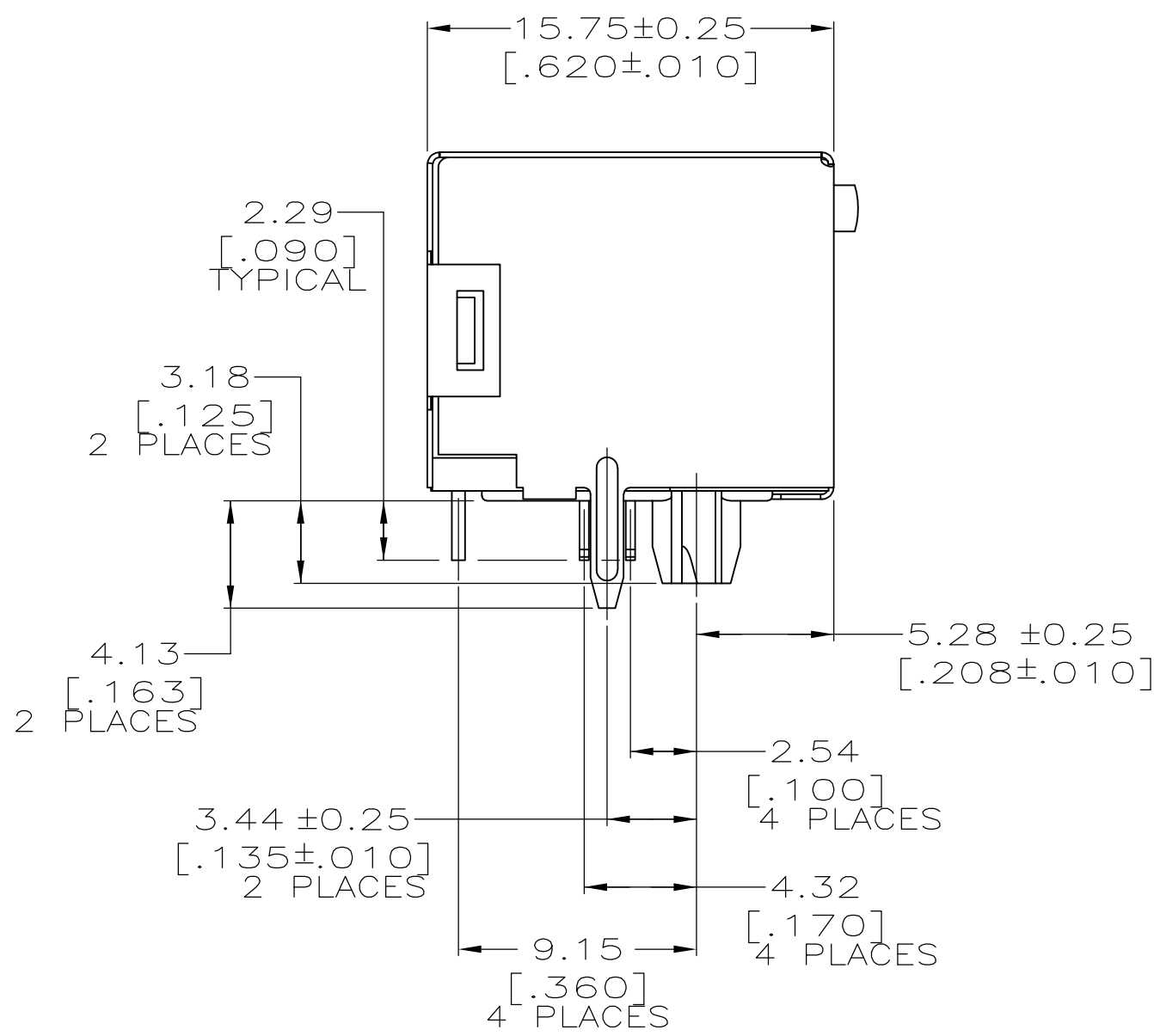
LOC	DIST	REVISIONS			
		REV	DESCRIPTION	DATE	BY
AA	22	A1	REVISED PER ECO-11-005033	28MAR11	RK

D

C

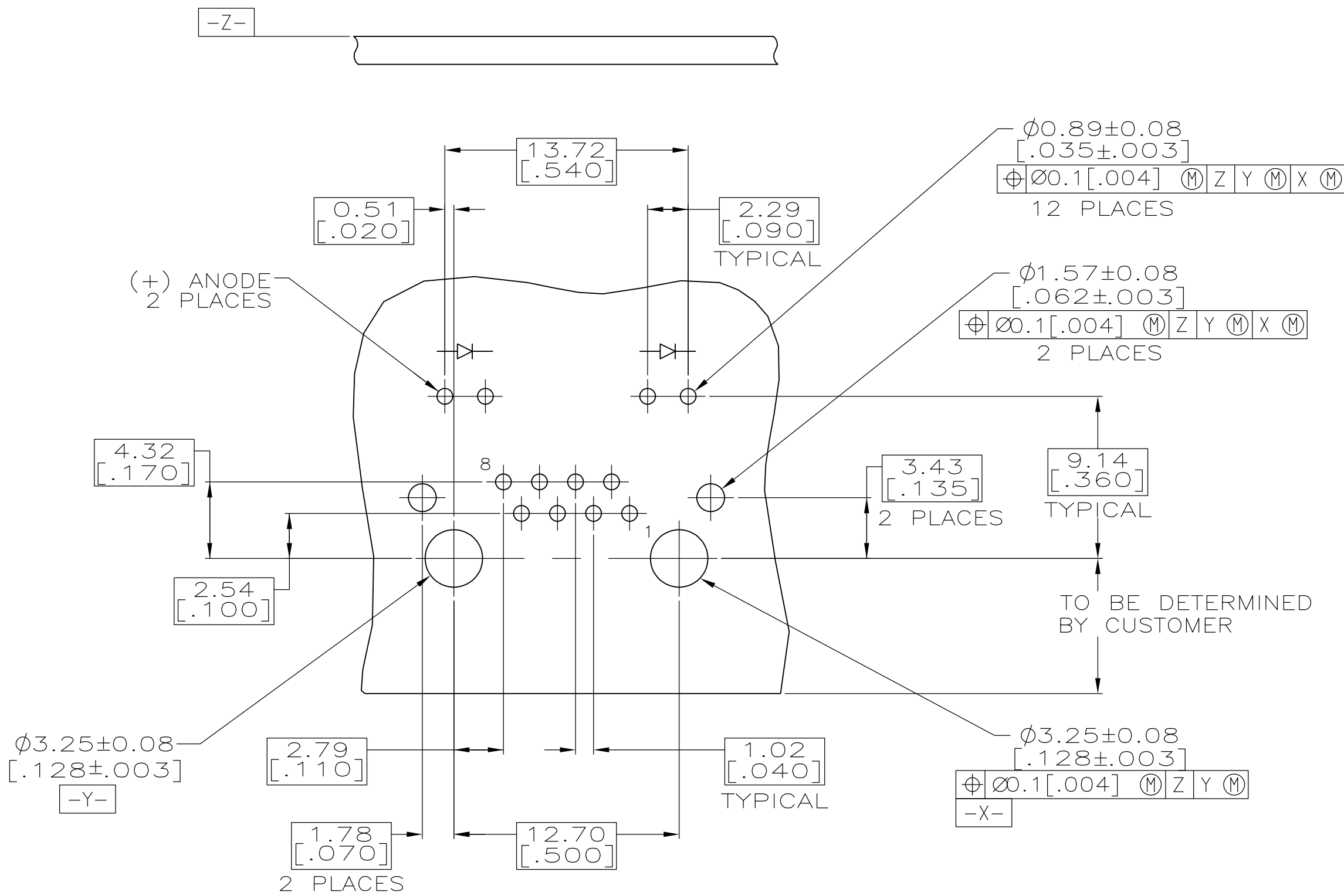
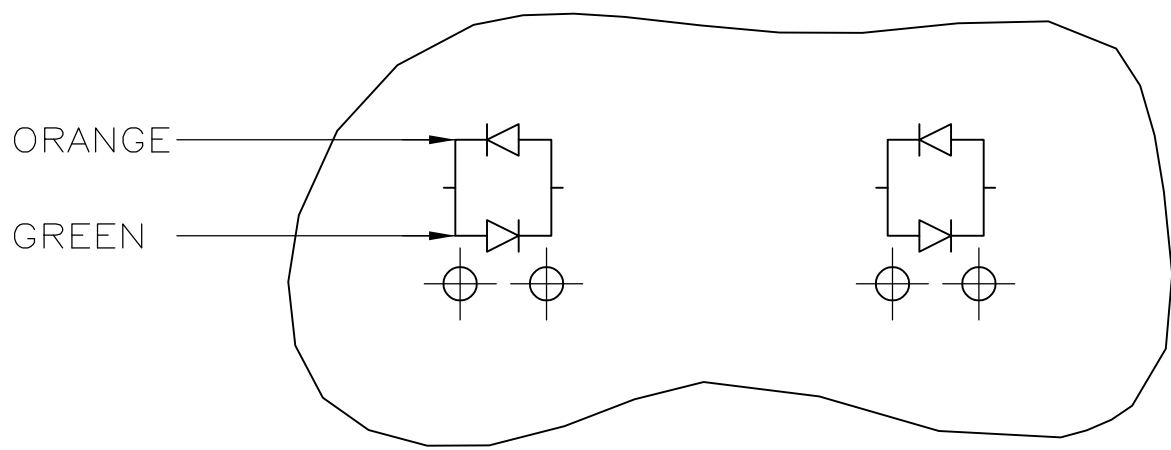
B

A



△ MATERIAL:
HOUSING – HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, BLACK, UL94V-0.
TERMINALS – 0.36 THICK PHOS BRONZE PLATED WITH 3.81 μm MIN THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA. 1.27 μm [.000050] MINIMUM GOLD IN LOCALIZED PLATE AREA. ENTIRE TERMINAL PLATED WITH 1.27 μm MIN THICK NICKEL.
SHIELD – 0.196 THICK COPPER ZINC ALLOY PREPLATED WITH 1.27 μm MIN SATIN NICKEL WITH 2.03 μm MIN TIN POST DIPPED ON PCB GROUND TABS.
LIGHT EMITTING DIODE (LED) – DIFFUSED EPOXY LENS, 0.51 x 0.51 CARBON STEEL WIREFRAME LEADS PREPLATED WITH 8.89 μm THICK Sn/Cu OVER 2.03 μm THICK Ag OVER 1.02 μm THICK Cu OVER 3.56 μm THICK Ni OVER 1.02 μm THICK Cu UNDERPLATE

- JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68, SUBPART F.
- △ SUGGESTED PANEL OPENING DIMENSIONS.
- △ SUGGESTED CLEARANCE BETWEEN TOP OF CONNECTOR AND TOP PANEL OPENING.
- △ SEE TABLE FOR COLOR OF LEDS AND NUMBER REQUIRED.
- THIS MODULAR JACK WITH INTEGRATED LED IS NOT IR REFLOW SOLDERING PROCESS COMPATIBLE.



SUGGESTED PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

ORANGE/GREEN	ORANGE/GREEN	6116075-7
YELLOW	YELLOW	6116075-6
GREEN	GREEN	6116075-5
GREEN	YELLOW	6116075-4
YELLOW	-	6116075-3
-	GREEN	6116075-2
YELLOW	GREEN	6116075-1
POSITION 2	POSITION 1	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T. SPRINKLE/L.A. MAYER CHK J. WESTMAN APVD S. FLICKINGER	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.25(.01) 3 PLC ± 0.13(.005) 4 PLC ± - ANGLES ± -	PRODUCT SPEC 114-2154 APPLICATION SPEC 108-1163-4	NAME INVERTED MODULAR JACK ASSEMBLY, 1X1, SHIELDED, LED	RESTRICTED TO
MATERIAL SEE NOTE 1	FINISH SEE NOTE 1	WEIGHT -	SIZE A1	SCALE 4:1
CUSTOMER DRAWING		SHEET 1 OF 1 REV A1		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9